

关于开展 2023 年海峡两岸暨港澳大学生 集成电路与电子设计邀请赛的通知

一、参赛主题

两岸四地·“芯”创未来

二、组织机构

主办单位：中国电子学会

承办单位：北京理工大学

三、参赛对象

参赛对象包括集成电路、微电子、电子、信息、通信、计算机、自动化、电气工程、仪器科学、生物医学等在校本科生及研究生。

四、竞赛方向

a.软件设计及仿真类：包括但不限于基于软件平台完成的创新创意仿真设计或软件系统。

b.硬件设计与智能终端类：包括但不限于针对某一功能应用所开展的具有较强创新创意的电子电路软硬件设计、智能终端设备或系统实现等。

c.集成电路设计类：包括但不限于采用各类集成电路设计软件完成的硅基或 III-V 化合物半导体集成电路设计。

d.其他有创意的集成电路与电子方向作品。

五、参赛形式

以参赛学校为单位统一申报或在推送链接中附带报名表，学生填写后经学校或学院盖章，上传发送至竞赛组委会官方邮箱。竞赛以团队形式参赛，学生自行组队，每个参赛队原则上不超过3人，每位同学只能参加一个参赛队，每队指导教师原则上不超过1人。请有意向参赛的学生下载报名表，按照小组的形式填写组员信息和指导教师信息，填写完成后发送至竞赛组委会官方邮箱：jcdlds@163.com。

作品提交形式及要求：Word+PPT+讲解视频；

Word：用文字概述设计理念及产品要素，不超过2000字；

PPT：图片+文字形式展示设计成果，内容不超过10页；

视频：简要讲解自己的设计方案及最终产品的展示，时长不超过3min。

注意：视频可通过链接的方式发送，保证其视频画质质量。

Word与PPT没有发送格式要求，参赛文件命名方式：学校+组别（a/b/c/d）+人数+组长姓名+指导教师，发送至邮箱：jcdlds@163.com。

六、参赛流程

时间	日程	内容
4月30日-5月31日	自行联系组队、报名	拟参赛选手沟通、联系，自行联系组队
5月31日	报名截止日期	

6月1日-6月30日	备赛
6月30日	终期作品提交截止日期
7月15日	特等奖候选队伍线上答辩与专家打分
7月20日	公布获奖名单
8月14日-8月16日	获奖团队赴北京参访
8月17日	颁奖仪式

备注：日程可能存在调整，以最终行程为准

七、奖项设置

特等奖(前5%)、一等奖(5%-20%)、二等奖(20%-40%)、优秀奖(40%-60%)、本科生单设奖项(如若队伍内成员都是本科生，可参评此奖项)

八、大赛组委会联系方式

联系邮箱：jcdlds@163.com

联系人：马老师

2023年海峡两岸暨港澳大学生
集成电路与电子设计邀请赛组委会
2023年4月25日